



2026-2032全球与中国晶圆解键合材料市场调研报告

【行业】:化工及材料 【报告编码】:179186089413723

【出版时间】:2026-10-13 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

内容摘要

根据统计及预测，2025年全球晶圆解键合材料市场销售额达到了2.77亿美元，预计2032年将达到4.51亿美元，年复合增长率（CAGR）为7.2%（2026-2032）。

晶圆解键合材料是用于临时固定器件晶圆与玻璃、硅或其他载体，并在减薄、背面刻蚀、沉积、重布线及封装工序完成后实现低应力分离的半导体工艺材料，主要包括临时键合胶、激光或光热释放层、热/溶剂可剥离膜及辅助胶带。核心指标包括键合强度、耐温与耐化学性、总厚度变化、低放气、解键合能量窗口、残留和薄晶圆损伤控制，通常需要与载体、涂布及解键合设备协同验证。综合毛利率约58%。

下游需求主要来自3D IC、TSV、HBM、Chiplet和扇出型封装，以及功率器件、MEMS和化合物半导体的超薄晶圆加工。随着晶圆厚度下降、封装尺寸扩大和背面工艺增加，产线对临时支撑强度、低应力解键合和良率稳定性的要求持续提高，材料由研发验证逐步转向量产耗材。

产品升级集中在低温键合与高温耐受兼顾、激光或光子快速释放、预制薄膜化、低放气、低残留和更宽工艺窗口。供应端仍以美国和日本专业材料厂商为主，材料通常与玻璃载体、涂布设备和解键合设备形成成套验证，客户更换供应商需要经过较长的可靠性和洁净度认证。

亚洲是主要需求区域，采购集中在中国台湾、韩国、中国大陆和日本的晶圆厂、封测厂及先进封装产线。本土替代机会主要在激光释放层、临时键合膜和高温胶体系，但仍面临设备兼容性、批次一致性、残留污染和客户平台锁定等风险；无载体加工或其他薄晶圆支撑路线的发展也可能分流部分需求。

报告范围

本报告研究全球与中国市场晶圆解键合材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年，预测数据为2026至2032年。

主要厂商包括：

Brewer Science
3M
东京应化工业
JSR
力森诺科
积水化学
AI Technology
日东电工
Mitsui Chemicals ICT Materia
Shin-Etsu MicroSi

按照不同耐受工艺温度，包括如下几个类别：

低温级（ $\leq 180^{\circ}\text{C}$ ）
标准温度级（ $>180-250^{\circ}\text{C}$ ）
高温级（ $>250-300^{\circ}\text{C}$ ）
超高温级（ $>300^{\circ}\text{C}$ ）

按照不同解键合方式，包括如下几个类别：

激光触发解键合

热触发解键合
溶剂触发解键合
UV产气解键合
直接机械解键合

按照不同供货形态，包括如下几个类别：

液态涂布材料
干膜材料
胶带材料
固态蜡质材料

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

基于TSV的3D IC封装
扇出型晶圆级封装
扇出型面板级封装
功率与射频半导体制造
MEMS与传感器制造
光电与显示器件制造

重点关注如下几个地区

北美
欧洲
中国
日本
印度
东南亚

章节概要

第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等

第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）

第3章：全球晶圆解键合材料主要地区分析，包括销量、销售收入等

第4章：全球范围内晶圆解键合材料主要厂商竞争分析，主要包括晶圆解键合材料产能、销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析

第5章：全球晶圆解键合材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、晶圆解键合材料产品型号、销量、收入、价格及最新动态等

第6章：全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量、收入、价格及份额等

第7章：全球不同应用晶圆解键合材料销量、收入、价格及份额等

第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等

第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等

第10章：报告结论

报告目录

1 晶圆解键合材料市场概述

1.1 产品定义及统计范围

1.2 按照不同耐受工艺温度，晶圆解键合材料主要可以分为如下几个类别

1.2.1 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.2.2 低温级（ $\leq 180^{\circ}\text{C}$ ）

1.2.3 标准温度级（ $>180-250^{\circ}\text{C}$ ）

1.2.4 高温级（ $>250-300^{\circ}\text{C}$ ）

1.2.5 超高温级（ $>300^{\circ}\text{C}$ ）

1.3 按照不同解键合方式，晶圆解键合材料主要可以分为如下几个类别

1.3.1 全球不同解键合方式晶圆解键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.3.2 激光触发解键合

1.3.3 热触发解键合

1.3.4 溶剂触发解键合

1.3.5 UV产气解键合

1.3.6 直接机械解键合

1.4 按照不同供货形态，晶圆解键合材料主要可以分为如下几个类别

1.4.1 全球不同供货形态晶圆解键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.4.2 液态涂布材料

1.4.3 干膜材料

1.4.4 胶带材料

1.4.5 固态蜡质材料

1.5 从不同应用，晶圆解键合材料主要包括如下几个方面

1.5.1 全球不同应用晶圆解键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.5.2 基于TSV的3D IC封装

1.5.3 扇出型晶圆级封装

1.5.4 扇出型面板级封装

1.5.5 功率与射频半导体制造

1.5.6 MEMS与传感器制造

1.5.7 光电与显示器件制造

1.6 晶圆解键合材料行业背景、发展历史、现状及趋势

1.6.1 晶圆解键合材料行业目前现状分析

1.6.2 晶圆解键合材料发展趋势

2 全球晶圆解键合材料总体规模分析

2.1 全球晶圆解键合材料供需现状及预测（2021-2032）

2.1.1 全球晶圆解键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

2.1.2 全球晶圆解键合材料产量、需求量及发展趋势（2021-2032）

2.2 全球主要地区晶圆解键合材料产量及发展趋势（2021-2032）

2.2.1 全球主要地区晶圆解键合材料产量（2021-2026）

2.2.2 全球主要地区晶圆解键合材料产量（2027-2032）

2.2.3 全球主要地区晶圆解键合材料产量市场份额（2021-2032）

2.3 中国晶圆解键合材料供需现状及预测（2021-2032）

2.3.1 中国晶圆解键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

2.3.2 中国晶圆解键合材料产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）

2.4 全球晶圆解键合材料销量及销售额

2.4.1 全球市场晶圆解键合材料销售额（2021-2032）

2.4.2 全球市场晶圆解键合材料销量（2021-2032）

2.4.3 全球市场晶圆解键合材料价格趋势（2021-2032）

3 全球晶圆解键合材料主要地区分析

3.1 全球主要地区晶圆解键合材料市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032

3.1.1 全球主要地区晶圆解键合材料销售收入及市场份额（2021-2026）

3.1.2 全球主要地区晶圆解键合材料销售收入预测（2027-2032）

3.2 全球主要地区晶圆解键合材料销量分析：2021 VS 2025 VS 2032

3.2.1 全球主要地区晶圆解键合材料销量及市场份额（2021-2026）

3.2.2 全球主要地区晶圆解键合材料销量及市场份额预测（2027-2032）

3.3 北美市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

3.4 欧洲市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

3.5 中国市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

3.6 日本市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

3.7 东南亚市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

3.8 印度市场晶圆解键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）

4 全球与中国主要厂商市场份额分析

4.1 全球市场主要厂商晶圆解键合材料产能市场份额

4.2 全球市场主要厂商晶圆解键合材料销量（2021-2026）

4.2.1 全球市场主要厂商晶圆解键合材料销量（2021-2026）

4.2.2 全球市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入（2021-2026）

4.2.3 全球市场主要厂商晶圆解键合材料销售价格（2021-2026）

4.2.4 2025年全球主要生产商品晶圆解键合材料收入排名

4.3 中国市场主要厂商晶圆解键合材料销量（2021-2026）

4.3.1 中国市场主要厂商晶圆解键合材料销量（2021-2026）

4.3.2 中国市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入（2021-2026）

4.3.3 2025年中国主要生产商品晶圆解键合材料收入排名

4.3.4 中国市场主要厂商晶圆解键合材料销售价格（2021-2026）

4.4 全球主要厂商晶圆解键合材料总部及产地分布

4.5 全球主要厂商成立时间及晶圆解键合材料商业化日期

4.6 全球主要厂商晶圆解键合材料产品类型及应用

4.7 晶圆解键合材料行业集中度、竞争程度分析

- 4.7.1 晶圆解键合材料行业集中度分析：2025年全球Top 5生产商市场份额
- 4.7.2 全球晶圆解键合材料第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
- 4.8 新增投资及市场并购活动
- 5 全球主要生产商分析
 - 5.1 Brewer Science
 - 5.1.1 Brewer Science基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.1.2 Brewer Science 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.1.3 Brewer Science 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.1.4 Brewer Science公司简介及主要业务
 - 5.1.5 Brewer Science企业最新动态
 - 5.2 3M
 - 5.2.1 3M基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.2.2 3M 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.2.3 3M 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.2.4 3M公司简介及主要业务
 - 5.2.5 3M企业最新动态
 - 5.3 东京应化工业
 - 5.3.1 东京应化工业基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.3.2 东京应化工业 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.3.3 东京应化工业 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.3.4 东京应化工业公司简介及主要业务
 - 5.3.5 东京应化工业企业最新动态
 - 5.4 JSR
 - 5.4.1 JSR基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.4.2 JSR 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.4.3 JSR 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.4.4 JSR公司简介及主要业务
 - 5.4.5 JSR企业最新动态
 - 5.5 力森诺科
 - 5.5.1 力森诺科基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.5.2 力森诺科 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.5.3 力森诺科 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.5.4 力森诺科公司简介及主要业务
 - 5.5.5 力森诺科企业最新动态
 - 5.6 积水化学
 - 5.6.1 积水化学基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.6.2 积水化学 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.6.3 积水化学 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.6.4 积水化学公司简介及主要业务
 - 5.6.5 积水化学企业最新动态
 - 5.7 AI Technology
 - 5.7.1 AI Technology基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.7.2 AI Technology 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.7.3 AI Technology 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.7.4 AI Technology公司简介及主要业务
 - 5.7.5 AI Technology企业最新动态
 - 5.8 日东电工
 - 5.8.1 日东电工基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.8.2 日东电工 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.8.3 日东电工 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.8.4 日东电工公司简介及主要业务
 - 5.8.5 日东电工企业最新动态
 - 5.9 Mitsui Chemicals ICT Materia
 - 5.9.1 Mitsui Chemicals ICT Materia基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.9.2 Mitsui Chemicals ICT Materia 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.9.3 Mitsui Chemicals ICT Materia 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.9.4 Mitsui Chemicals ICT Materia公司简介及主要业务
 - 5.9.5 Mitsui Chemicals ICT Materia企业最新动态
 - 5.10 Shin-Etsu MicroSi
 - 5.10.1 Shin-Etsu MicroSi基本信息、晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

- 5.10.2 Shin-Etsu MicroSi 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
- 5.10.3 Shin-Etsu MicroSi 晶圆解键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
- 5.10.4 Shin-Etsu MicroSi公司简介及主要业务
- 5.10.5 Shin-Etsu MicroSi企业最新动态
- 6 不同耐受工艺温度晶圆解键合材料分析
 - 6.1 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量（2021-2032）
 - 6.1.1 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 - 6.1.2 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量预测（2027-2032）
 - 6.2 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入（2021-2032）
 - 6.2.1 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入及市场份额（2021-2026）
 - 6.2.2 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入预测（2027-2032）
 - 6.3 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料价格走势（2021-2032）
- 7 不同应用晶圆解键合材料分析
 - 7.1 全球不同应用晶圆解键合材料销量（2021-2032）
 - 7.1.1 全球不同应用晶圆解键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 - 7.1.2 全球不同应用晶圆解键合材料销量预测（2027-2032）
 - 7.2 全球不同应用晶圆解键合材料收入（2021-2032）
 - 7.2.1 全球不同应用晶圆解键合材料收入及市场份额（2021-2026）
 - 7.2.2 全球不同应用晶圆解键合材料收入预测（2027-2032）
 - 7.3 全球不同应用晶圆解键合材料价格走势（2021-2032）
- 8 上游原料及下游市场分析
 - 8.1 晶圆解键合材料产业链分析
 - 8.2 晶圆解键合材料工艺制造技术分析
 - 8.3 晶圆解键合材料产业上游供应分析
 - 8.3.1 上游原料供给状况
 - 8.3.2 原料供应商及联系方式
 - 8.4 晶圆解键合材料下游客户分析
 - 8.5 晶圆解键合材料销售渠道分析
- 9 行业发展机遇和风险分析
 - 9.1 晶圆解键合材料行业发展机遇及主要驱动因素
 - 9.2 晶圆解键合材料行业发展面临的风险
 - 9.3 晶圆解键合材料行业政策分析
 - 9.4 美国对华关税对行业的影响分析
 - 9.5 中国企业SWOT分析
- 10 研究成果及结论
- 11 附录
 - 11.1 研究方法
 - 11.2 数据来源
 - 11.2.1 二手信息来源
 - 11.2.2 一手信息来源
 - 11.3 数据交互验证
 - 11.4 免责声明

报告图表

表格目录

- 表 1： 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 2： 全球不同解键合方式晶圆解键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 3： 全球不同供货形态晶圆解键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 4： 全球不同应用销售额增速（CAGR） 2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 5： 晶圆解键合材料行业目前发展现状
- 表 6： 晶圆解键合材料发展趋势
- 表 7： 全球主要地区晶圆解键合材料产量增速（CAGR）：（2021 VS 2025 VS 2032）&（千克）
- 表 8： 全球主要地区晶圆解键合材料产量（2021-2026）&（千克）
- 表 9： 全球主要地区晶圆解键合材料产量（2027-2032）&（千克）

表 10:	全球主要地区晶圆解键合材料产量市场份额 (2021-2026)
表 11:	全球主要地区晶圆解键合材料产量市场份额 (2027-2032)
表 12:	全球主要地区晶圆解键合材料销售收入增速: (2021 VS 2025 VS 2032) & (百万美元)
表 13:	全球主要地区晶圆解键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 14:	全球主要地区晶圆解键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 15:	全球主要地区晶圆解键合材料收入 (2027-2032) & (百万美元)
表 16:	全球主要地区晶圆解键合材料收入市场份额 (2027-2032)
表 17:	全球主要地区晶圆解键合材料销量 (千克): 2021 VS 2025 VS 2032
表 18:	全球主要地区晶圆解键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 19:	全球主要地区晶圆解键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 20:	全球主要地区晶圆解键合材料销量 (2027-2032) & (千克)
表 21:	全球主要地区晶圆解键合材料销量份额 (2027-2032)
表 22:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料产能 (2025-2026) & (千克)
表 23:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 24:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 25:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 26:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 27:	全球市场主要厂商晶圆解键合材料销售价格 (2021-2026) & (美元/千克)
表 28:	2025年全球主要生产商品晶圆解键合材料收入排名 (百万美元)
表 29:	中国市场主要厂商晶圆解键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 30:	中国市场主要厂商晶圆解键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 31:	中国市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 32:	中国市场主要厂商晶圆解键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 33:	2025年中国主要生产商品晶圆解键合材料收入排名 (百万美元)
表 34:	中国市场主要厂商晶圆解键合材料销售价格 (2021-2026) & (美元/千克)
表 35:	全球主要厂商晶圆解键合材料总部及产地分布
表 36:	全球主要厂商成立时间及晶圆解键合材料商业化日期
表 37:	全球主要厂商晶圆解键合材料产品类型及应用
表 38:	2025年全球晶圆解键合材料主要厂商市场地位 (第一梯队、第二梯队和第三梯队)
表 39:	全球晶圆解键合材料市场投资、并购等现状分析
表 40:	Brewer Science 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 41:	Brewer Science 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 42:	Brewer Science 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 43:	Brewer Science公司简介及主要业务
表 44:	Brewer Science企业最新动态
表 45:	3M 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 46:	3M 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 47:	3M 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 48:	3M公司简介及主要业务
表 49:	3M企业最新动态
表 50:	东京应化工业 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 51:	东京应化工业 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 52:	东京应化工业 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 53:	东京应化工业公司简介及主要业务
表 54:	东京应化工业企业最新动态
表 55:	JSR 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 56:	JSR 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 57:	JSR 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 58:	JSR公司简介及主要业务
表 59:	JSR企业最新动态
表 60:	力森诺科 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 61:	力森诺科 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 62:	力森诺科 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 63:	力森诺科公司简介及主要业务
表 64:	力森诺科企业最新动态
表 65:	积水化学 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 66:	积水化学 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用
表 67:	积水化学 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 68:	积水化学公司简介及主要业务
表 69:	积水化学企业最新动态

表 70: AI Technology 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 71: AI Technology 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用

表 72: AI Technology 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)

表 73: AI Technology公司简介及主要业务

表 74: AI Technology企业最新动态

表 75: 日东电工 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 76: 日东电工 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用

表 77: 日东电工 晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)

表 78: 日东电工公司简介及主要业务

表 79: 日东电工企业最新动态

表 80: Mitsui Chemicals ICT Materia 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 81: Mitsui Chemicals ICT Materia 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用

表 82: Mitsui Chemicals ICT Materia

晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)

表 83: Mitsui Chemicals ICT Materia公司简介及主要业务

表 84: Mitsui Chemicals ICT Materia企业最新动态

表 85: Shin-Etsu MicroSi 晶圆解键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

表 86: Shin-Etsu MicroSi 晶圆解键合材料产品规格、参数及市场应用

表 87: Shin-Etsu MicroSi

晶圆解键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)

表 88: Shin-Etsu MicroSi公司简介及主要业务

表 89: Shin-Etsu MicroSi企业最新动态

表 90: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量 (2021-2026) & (千克)

表 91: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量市场份额 (2021-2026)

表 92: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量预测 (2027-2032) & (千克)

表 93: 全球市场不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量市场份额预测 (2027-2032)

表 94: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 95: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入市场份额 (2021-2026)

表 96: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入预测 (2027-2032) & (百万美元)

表 97: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料收入市场份额预测 (2027-2032)

表 98: 全球不同应用晶圆解键合材料销量 (2021-2026) & (千克)

表 99: 全球不同应用晶圆解键合材料销量市场份额 (2021-2026)

表 100: 全球不同应用晶圆解键合材料销量预测 (2027-2032) & (千克)

表 101: 全球市场不同应用晶圆解键合材料销量市场份额预测 (2027-2032)

表 102: 全球不同应用晶圆解键合材料收入 (2021-2026) & (百万美元)

表 103: 全球不同应用晶圆解键合材料收入市场份额 (2021-2026)

表 104: 全球不同应用晶圆解键合材料收入预测 (2027-2032) & (百万美元)

表 105: 全球不同应用晶圆解键合材料收入市场份额预测 (2027-2032)

表 106: 晶圆解键合材料上游原料供应商及联系方式列表

表 107: 晶圆解键合材料典型客户列表

表 108: 晶圆解键合材料主要销售模式及销售渠道

表 109: 晶圆解键合材料行业发展机遇及主要驱动因素

表 110: 晶圆解键合材料行业发展面临的风险

表 111: 晶圆解键合材料行业政策分析

表 112: 研究范围

表 113: 本文分析师列表

图表目录

图 1: 晶圆解键合材料产品图片

图 2: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 3: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料市场份额2025 & 2032

图 4: 低温级 (≤180℃) 产品图片

图 5: 标准温度级 (>180–250℃) 产品图片

图 6: 高温级 (>250–300℃) 产品图片

图 7: 超高温级 (>300℃) 产品图片

图 8: 全球不同解键合方式晶圆解键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)

图 9: 全球不同解键合方式晶圆解键合材料市场份额2025 & 2032

图 10: 激光触发解键合产品图片

图 11: 热触发解键合产品图片

图 12: 溶剂触发解键合产品图片
图 13: UV产气解键合产品图片
图 14: 直接机械解键合产品图片
图 15: 全球不同供货形态晶圆解键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 16: 全球不同供货形态晶圆解键合材料市场份额2025 & 2032
图 17: 液态涂布材料产品图片
图 18: 干膜材料产品图片
图 19: 胶带材料产品图片
图 20: 固态蜡质材料产品图片
图 21: 全球不同应用销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 22: 全球不同应用晶圆解键合材料市场份额2025 & 2032
图 23: 基于TSV的3D IC封装
图 24: 扇出型晶圆级封装
图 25: 扇出型面板级封装
图 26: 功率与射频半导体制造
图 27: MEMS与传感器制造
图 28: 光电与显示器件制造
图 29: 全球晶圆解键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 30: 全球晶圆解键合材料产量、需求量及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 31: 全球主要地区晶圆解键合材料产量 (2021 VS 2025 VS 2032) & (千克)
图 32: 全球主要地区晶圆解键合材料产量市场份额 (2021-2032)
图 33: 中国晶圆解键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 34: 中国晶圆解键合材料产量、市场需求量及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 35: 全球晶圆解键合材料市场销售额及增长率: (2021-2032) & (百万美元)
图 36: 全球市场晶圆解键合材料市场规模: 2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 37: 全球市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 38: 全球市场晶圆解键合材料价格趋势 (2021-2032) & (美元/千克)
图 39: 全球主要地区晶圆解键合材料销售收入 (2021 VS 2025 VS 2032) & (百万美元)
图 40: 全球主要地区晶圆解键合材料销售收入市场份额 (2021 VS 2025)
图 41: 北美市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 42: 北美市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 43: 欧洲市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 44: 欧洲市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 45: 中国市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 46: 中国市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 47: 日本市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 48: 日本市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 49: 东南亚市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 50: 东南亚市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 51: 印度市场晶圆解键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 52: 印度市场晶圆解键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
图 53: 2025年全球市场主要厂商晶圆解键合材料销量市场份额
图 54: 2025年全球市场主要厂商晶圆解键合材料收入市场份额
图 55: 2025年中国市场主要厂商晶圆解键合材料销量市场份额
图 56: 2025年中国市场主要厂商晶圆解键合材料收入市场份额
图 57: 2025年全球前五大生产商品晶圆解键合材料市场份额
图 58: 2025年全球晶圆解键合材料第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图 59: 全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料价格走势 (2021-2032) & (美元/千克)
图 60: 全球不同应用晶圆解键合材料价格走势 (2021-2032) & (美元/千克)
图 61: 晶圆解键合材料产业链
图 62: 晶圆解键合材料中国企业SWOT分析
图 63: 关键采访目标
图 64: 自下而上及自上而下验证
图 65: 资料三角测定